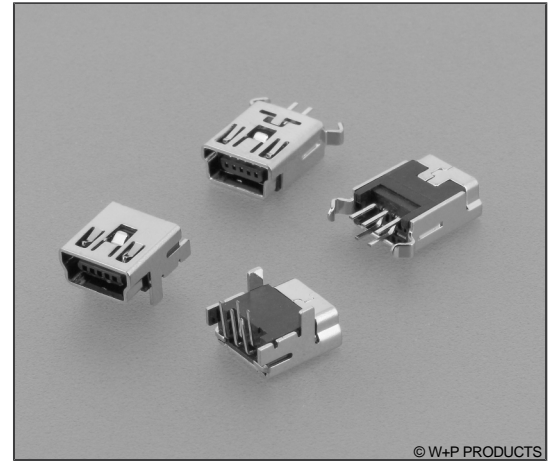


Mini-USB Steckverbinder, Typ B, Buchsen gerade/gewinkelt

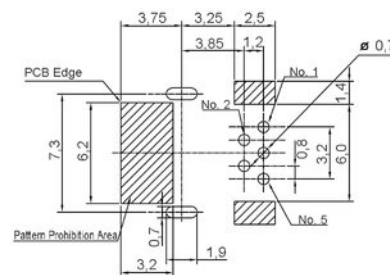
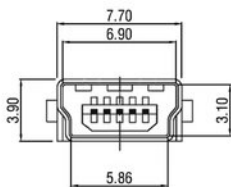
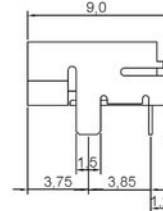
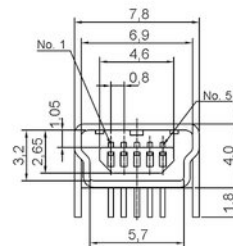
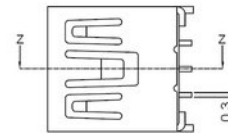
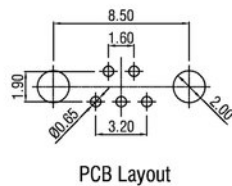
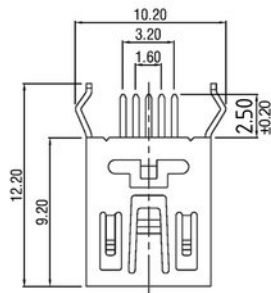
Mini-USB Connectors, Type B, Jacks Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing, verzinkt
Shell	Tin plated brass
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	Gold over nickel (see options below)
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	Tin plated over nickel
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennspannung	30 V RMS
Voltage Rating	30 V RMS
Nennstrom	1,5 A bei 25°C
Current Rating	1,5 A at 25°C
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C
Temperature Range	-55 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS



Series	Type	Contacts	Version*	Plating*
825	2	05	1	80
	2 Type B (female)		1 Eingang oben Top entry 2 Eingang seitlich Side entry	60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0; C=2,1mm)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

